

# SID

Werk: Rot am See

Artikel:

ML4

Erstellt:

Wodke, Alexander

Kunde:

Datum:

06.09.2022



Prozesstechnik: B: Pinlamination

| Materialtext | Mat. Nr. | µm | Aufbau | Prozessaufbau |
|--------------|----------|----|--------|---------------|
|--------------|----------|----|--------|---------------|

|                                     |          |     |    |   |         |
|-------------------------------------|----------|-----|----|---|---------|
| A-RS Kupferfolie-009my 330x490mm    | 50201012 | 9   | VS | 1 | A00 B00 |
| A-RS-FR4-Prepreg-1080-TG150-HF      | 50200641 | 60  |    | 2 |         |
| B-RS-FR4-ML-0.61mm-018+018-TG150-HF | 50201009 | 33  | L2 | 3 |         |
|                                     |          | 610 |    |   |         |
|                                     |          | 33  | L3 |   |         |
| A-RS-FR4-Prepreg-1080-TG150-HF      | 50200641 | 60  |    | 4 |         |
| A-RS Kupferfolie-009my 330x490mm    | 50201012 | 9   | RS | 5 |         |

Dicke nach Verpressen

B00: 890 µm Tol+: 100 µm Tol-: 100 µm Dmax: 990 µm Dmin: 790 µm

Gesamtdicke über alles

0 µm Tol+: 0 µm Tol-: 0 µm Dmax: 0 µm Dmin: 0 µm

Kundenforderung

Dicke (D): 1000 µm Tol+: 100 µm Tol-: 100 µm Dmax: 1100 µm Dmin: 900 µm

Messstelle: (05) über LM und galv.Cu; beidseitig nominal: 814 µm

Version 1.2.20.19

© Würth Elektronik